力士科技(4923)0214 新聞稿

力士挾自有專利、製程　喜獲國際大廠 MOSFET 合格供應商

看好快充、車用應用引爆市場商機　訂單能見度看旺至年底

2022 年 2 月 14 日，新北

台灣 MOSFET 技術集成電路設計之先驅廠商力士科技股份有限公司(以下簡稱力士，股票代號 4923) 看好 5G、AI、工業自動化、新能源車等終端市場需求高漲，加上全球晶片荒情況尚未緩解，使得全球 MOSFET 整體市場仍持續保持供不應求局面，憑藉力士擁有高效能 MOSFET 設計能力、專利、專屬晶圓代工廠與封測廠製程平台、穩定的產品品質及供貨量等高度的競爭力，繼 2021 年已取得國際筆電品牌 HP 充電變壓器(Adapter)之台灣唯二 MOSFET 合格供應商，更於 1 月成功喜獲全球前三大筆電品牌之一的 DELL 小訊號 MOSFET 合格供應商資格，有助於擴大旗下 MOSFET 產品市場滲透率，並持續深化與既有客戶共同合作開發瞄準快充、車用、充電樁等符合未來市場高度需求應用之 MOSFET 產品，有信心創造未來營運邁入下一成長期。

MOSFET 設計黑馬-力士科技耕耘中低壓 MOSFET 領域已長達 14 年基礎，主力產品包括 MOSFET 成品、半成品晶圓片 Wafer 等合計占整體營收近八成，產品應用涵蓋 PC/NB、手機、電池、TV 面板等領域，為業界少數擁有共 91 件豐富專利布局，並與專屬晶圓代工廠與封測廠封閉式製程平台滿足客戶高客製化產品需求，更是為大中華地區第一家擁有自主性 8 吋晶圓與 0.18 微米溝槽式功率金氧半場效電晶體(Power MOSFET)之半導體製程技術開發和元件設計能力業者，係力士搶進各應用領域國際知名大廠之重要關鍵。

力士表示，隨著終端市場應用升級、先進封裝趨勢，積極深化 MOSFET 產品研發朝晶片微縮化、高功率、大電流、優異散熱效能、產品效率升級等技術提升，包括於 2018 年成功研發水平分離式閘極結構製程平台(Split Gate)、RTG 等新型晶片設計，以及 2020 年亦推出銅夾片封裝、晶片尺寸封裝(CSP)等封裝技術，隨著新型結構晶片設計、封裝技術導入 MOSFET 新產品應用，加上公司積極拓展 MOSFET 成品、半成品 Wafer 兩大業務表現，並透過業務接單結構優化等，帶動力士 2021 年前三季合併營收達 8.30 億元、稅後淨利 1 億元、每股稅後盈餘(EPS)4.11 元，前三季獲利表現創下公司成立以來全年獲利新高，整體獲利表現更是 MOSFET 產業績優生。

根據專業研究機構 TrendForce 最新統計，由於全球晶片供應緊缺，加上車用、消費電子、工業用市場需求持續高漲，帶動全球 MOSFET 市場供應缺口加劇，除預估 2021 年全球功率半導體元件市場規模達 97 億美元、年增 22.8%，看好未來消費電子需求穩健、車用市場持續增溫，2022 年整體 MOSFET 市場規模將達百億美元大關，持續創造力士業務良好發展環境。力士指出，以 2021 年前三季 PC/NB、手機、電池、TV 面板、網通、電源供應器等營收比重來看，分別為 36%、26%、14%、11%、2%、1%，隨著去年取得 HP 合格供應商帶動筆電充電變壓器產品逐步放量、加上陸續於電池、電源供應器、車用等布局展開，有助於帶動 NB、電池、電源供應器將注入整體營運新一動能。

展望未來營運，力士仍戮力透過豐富自有專利、自有製程等高度研發技術實力、專屬晶圓代工廠深厚業務合作、以及擁有國際廠商之認證及採用，持續擴大公司多元領域接單布局，尤其受惠 NB、電池、手機等產業客戶持續加大 MOSFET 成品拉貨力道，帶動 1 月合併營收達 1.03 億元、年增 14.75%，刷新歷史單月新高，除此之外，公司經營團隊積極開創新商業模式、切入藍海市場，以避

力士科技(4923)0214 新聞稿

開產品價格競爭，在新型 MOSFET 專利設計架構所推出新一代 ETG 產品系列已通過多方客戶之量產驗證，且客戶對於產品品質與穩定度皆有高度認可，力士有望隨著主要客戶的需求持續增加，助力公司新一波營運成長動能，創造未來營運成長可期。

新聞聯繫人：

力士科技	發言人	鍾秉家	(02)8976-9223 ir@force-mos.com
IR Trust	副總經理	鄭友慈	(02)2585-5701/0931-914467 sandy@ir-trust.tw

關於力士科技：

力士科技(股票代號：4923)成立於 2007 年，為台灣無晶圓廠專業功率電力電子元件與製程開發設計公司，主要營業項目為溝槽式功率金氧半功率場效電晶體（Trench Power MOSFET）和溝槽式功率絕緣閘雙載子功率場效電晶體（Trench IGBT）之研發設計，目前公司在美國、台灣、中國等地皆在進行溝槽式 MOSFET 製程與元件專利申請，並已取得 91 項專利認證。

憑藉多年專業經驗執行監督及調整製程，完全掌控產品良率及縮短生產週期，公司不斷擴展銷售市場領域，積極投入設計開發新的優良產品，並深信不斷精進是維持領先的唯一方法，目前擁有類比 IC、MOSFET、肖特基二極體和被動零件等銷售項目，其中 MOSFET 製程主要使用先進的 0.25/0.18/0.13 μm 製程技術，全方位應用在低壓及中電壓領域，廣泛應用在筆記型電腦、主機板、顯示器、數位相機、手機通訊等 3C 產品線路設計，而 IGBT 產品則主要用於電源產業，作用於讓功率消耗最小化、能源效率最大化，公司仍將致力於創新技術、追求卓越，以成為產業標竿為目標前進。

聲明：

本文件及同時發佈之相關資訊內含有預測性敘述。除針對已發生事實，所有力士(以下簡稱本公司)未來經營業務、可能發生之事件及展望(包括但不限於預測、目標、估算和營運計畫)之敘述皆屬預測性敘述。預測性敘述會受不同因素及不確定性的影響，造成與實際情況有相當差異，這些因素包括但不限於價格波動、實際需求、匯率變動、市占率、市場競爭情況，法律、金融及法規架構的改變、國際經濟暨金融市場情勢、政治風險、成本估計等，及其他本公司控制範圍以外的風險與變數。這些預測性敘述是基於現況的預測和評估，本公司不負日後更新之責。